05

## Тепло- и электропроводность текстурированных подложек для высокотемпературных сверхпроводников из сплавов Ni–Cr–W

© Л.Н. Ханов, А.Б. Батдалов, А.М. Алиев, С.В. Самойленков, А.Р. Кауль

Институт физики ДагНЦ РАН, Махачкала E-mail: hanov82@mail.ru Объединенный институт высоких температур РАН, Москва Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

## Поступило в Редакцию 28 февраля 2012 г.

Измерены электропроводность, теплопроводность, теплоемкость, термодиффузия тонких ленточных образцов из сплава Ni<sub>87.8</sub>Cr<sub>9.3</sub>W<sub>2.9</sub>. Показано, что образцы с кубической текстурой обладают лучшими проводящими свойствами по сравнению с нетекстурированными. Разделены электронная и фононная составляющие теплопроводности и прослежена их температурная зависимость. Обнаружены аномалии, связанные с переходом образца в ферромагнитное состояние.

оксидных Открытие высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) с температурой перехода в сверхпроводящее состояние выше 77 К существенно расширило возможности применения сверхпроводников в электронике и электротехнике [1]. Для создания высокомощного сверхпроводникового оборудования (кабелей, токоограничителей, генераторов, моторов, магнитов) необходимы гибкие провода большой длины. Так как оксидные ВТСП-материалы являются хрупкими соединениями, непосредственное изготовление из них проводов представляется сложной технической задачей. Поэтому наиболее перспективными в этом направлении являются так называемые ВТСП-провода второго поколения, представляющие собой тонкие, гибкие металлические ленты, на которые нанесены текстурированные сверхпроводящие пленки из ВТСП-материалов, преимущественно YBa2Cu3O7-у [2]. Плотность тока в таких ВТСП-слоях достигает значений, представляющих практический

48

интерес (>  $10^6$  А/сm<sup>2</sup> при T = 77 К [3,4]). Для предотвращения химического взаимодействия между ВТСП-пленкой и металлической лентойподложкой располагается изолирующий оксидный буферный слой из таких материалов, как CeO<sub>2</sub>, MnO, LaMnO<sub>3</sub> и др. Обычно в качестве положек используются сплавы ГЦК-металлов с острой кубической текстурой, формируемой путем холодной прокатки с последующим отжигом. Кубическая текстура металлической ленты крайне важна, так как она передается слою ВТСП через буферный слой, что и обусловливает высокие токонесущие характеристики сверхпроводника.

В последние годы активно ведется поиск немагнитных сплавов на никелевой основе с совершенной кубической текстурой для изготовления текстурированных лент-подложек, обладающих высокой прочностью и повышенной стойкостью к высокотемпературному окислению при нанесении буферных слоев. Отсутствие ферромагнитных свойств материала подложки необходимо для снижения потерь при применении ВТСП-проводов на переменном токе. Сплавы Ni–Cr–W являются перспективными с этой точки зрения материалами, так как можно подобрать такое соотношение компонент сплава, чтобы было возможно формирование кубической текстуры и в то же время температура Кюри подложки не превышала рабочей температуры сверхпроводника (77 K) [5].

Исследование теплопроводности и электропроводности таких подложек является актуальной практической задачей, так как без учета коэффициента теплопроводности используемых материалов нельзя рассчитать и создать ни одно техническое устройство, в том числе на основе высокотемпературных сверхпроводников. Вопросы теплопереноса в случае ВТСП-проводов являются крайне важными еще и потому, что в случае превышения критической плотности тока в сверхпроводнике он переходит в нормальное (резистивное) состояние, что сопровождается выделением большого количества тепла и может привести к перегоранию провода.

В данном сообщении приводятся результаты экспериментальных исследований электросопротивления ( $\rho$ ), теплопроводности ( $\kappa$ ), теплопроводности ( $C_p$ ) и термодиффузии ( $\eta$ ) подложек из сплава Ni<sub>87.8</sub>Cr<sub>9.3</sub>W<sub>2.9</sub> в широкой области температур. Были исследованы два образца данного состава, один из которых был вырезан из ленты сразу после холодной прокатки, а другой — после того, как лента

прошла рекристаллизационный отжиг при T = 1273 K, необходимый для получения острой кубической текстуры [5–7].

Исследованные образцы представляли собой тонкие прямоугольные гибкие пластинки размерами  $15 \times 3 \times 0.1$  mm. Электросопротивление измерялось четырехзондовым методом, теплопроводность — методом стационарного теплового поткоа. В качестве датчиков температуры служили медь-константановые (T > 77 K) и хромель-константановые (T < 77 K) термопары.

Отдельно проводились измерения теплоемкости  $(C_p)$  и термодиффузии  $(\eta)$  методом модуляционной калориметрии [8], на основании которых также определялась теплопроводность

$$k=\frac{d}{M}C_p\eta,$$

где *М* — молярная масса, *d* — плотность образца. Определенные обоими методами значения теплопроводности согласуются друг с другом в пределах точности эксперимента.

Результаты экспериментальных иссследований приведены на рис. 1-4.

Температурная зависимость электросопротивления  $\rho(T)$  в исследованном интервале температур, как видно из рис. 1, носит металлический характер, а сами значения электросопротивления находятся в интервале обычных величин, характерных для сложных металлических сплавов.

Из рисунка также видно, что рекристаллизационный отжиг, приводящий к получению совершенной кубической текстуры [6], сопровождается уменьшением электросопротивления образца, что соответствует существующим представлениям о механизмах расеяния электронов проводимости в металлических сплавах.

Такое поведение  $\rho(T)$  характерно для металлических сплавов, в которых скорость рассеяния электронов определяют фононы, дающие в этой области вклад, пропорциональный  $T(\tau_{e-ph}^{-1} \sim T, \tau)$  время релаксации), и статические дефекты, скорость рассеяния на которых не зависит от T, т.е.  $\rho(T) = \rho_0 + \alpha T$  ( $\alpha$  — температурный коэффициент сопротивления). Тенденция к ослаблению зависимости  $\rho(T)$  с увеличением T может означать уменьшение вклада колебаний кристаллической решетки в рассеяние электронов.

Перейдем к обсуждению результатов по теплопроводности. В качестве подложек для ВТСП-пленок желательно иметь материалы с



**Рис. 1.** Температурная зависимость электросопротивления образцов Ni<sub>7.8</sub>Cr<sub>9.3</sub>W<sub>2.9</sub>: *1* — текстурированный, *2* — нетекстурированный.

высокой теплопроводностью для ускорения теплообмена. Эффективный теплоперенос крайне важен при переходе части сверхпроводника в нормальное состояние, например при превышении критической плотности тока. В то же время известно, что сплавы как правило, имеют относительно невысокую теплопроводность, причем электронная ( $\kappa_e$ ) и фононная ( $\kappa_{ph}$ ) составляющие теплопроводности — величины одного порядка [9].

На рис. 2 приведена температурная зависимость теплопроводности отожженного (1) и неотожженного (2) образцов. Как видно из рисунка, поведение  $\kappa_{exp}$  напоминает поведение теплоемкости (рис. 4), что характерно для некристаллических твердых тел [9], в которых основным, зависящим от температуры параметром, входящим в выражение для теплопроводности  $\kappa_{ph} = (1/3)C_V l_{ph}v_S$  ( $C_v$  — теплоемкость единицы объема,  $l_{ph}$  — средняя длина свободного пробега фононов,  $v_S$  —



**Рис. 2.** Зависимость теплопроводности образцов Ni<sub>87.8</sub>Cr<sub>9.3</sub>W<sub>2.9</sub> от температуры: *1* — текстурированный, *2* — нетекстурированный.

скорость звука), является теплоемкость, при этом  $l_{ph}$  ограничена структурными несовершенствами решетки.

На рис. З приведены результаты разделения электронной и фононной составляющих теплопроводности текстурированного образца. Отметим, что в чистых металлах  $\kappa_e \gg \kappa_{ph}$ , таке что при анализе  $\kappa(T)$ фононной составляющей теплопроводности можно пренебречь, в то время как в сплавах  $\kappa_e$  и  $\kappa_{ph}$  — сопоставимые величины и такое допущение не правомочно.

Для выделения  $\kappa_e$  в сильно разбавленных сплавах можно воспользоваться соотношением Видемана–Франца  $\kappa_e = L_0 T/\rho$ , где  $L_0 = 2.44 \cdot 10^{-8} \text{ V}^2/\text{K}^2$  — число Лоренца [9]. В таком случае фононная составляющая находится как разность

$$\kappa_{ph} = \kappa_{exp} - \kappa_e$$



Рис. 3. График зависимости  $\kappa = f(T)$  Ni<sub>87.8</sub>Cr<sub>9.3</sub>W<sub>2.9</sub> (текстурированный).

Как видно из рис. 3,  $\kappa_e$  и  $\kappa_{ph}$  — величины одного порядка, причем  $\kappa_{ph} > \kappa_e$ . Количественное соотношение между ними меняется с температурой: при T = 100 К  $\kappa_e/\kappa_{exp} = 0.15$ , а при T = 280 К это отношение равно 0.26. Такое поведение объясняется тем, что при высоких температурах  $\kappa_{ph} \sim 1/T$ , в то время как  $\kappa_e$  либо постоянна, либо слабо растет с T.

Отсюда следует, что разница в значениях  $\kappa_{\rm exp}$  для текстурированного и нетекстурированного образцов может быть связана с изменением скорости рассеяния как фононов, так и электронов. Анализ показывает, что  $\Delta \kappa_e$ , оцененное на основании данных по  $\rho(T)$  с использованием соотношения Видемана—Франца, на порядок меньше экспериментально наблюдаемой разницы в теплопроводности ( $\Delta \kappa_e \approx 0.22 \text{ W/(m \cdot K)}$ ,  $\Delta \kappa_{exp} \approx 3.5 \text{ W/(m \cdot K)}$  при 100 K), т.е. формирование острой кубической текстуры влияет в основном на фононную теплопроводность.



Рис. 4. Температурная зависимость теплоемкости и термодиффузии  $Ni_{87.8}Cr_{9.3}W_{2.9}$  (образец № 1).

Из рис. З также следует, что  $\kappa_{ph}$  проходит через растянутый по температуре максимум, что может означать смену доминирующего механизма рассеяния фононов от фонон-дефектного к фонон-фононному.

Отметим еще одну особенность в поведении  $C_P(T)$  и  $\kappa(T)$  при низких температурах, которая хорошо видна на рис. 3 и 4 в виде изломов на кривых при  $T \approx 40$  К. Согласно [3], при T = 45 К ленточный образец Ni<sub>87.8</sub>Cr<sub>9.3</sub>W<sub>2.9</sub> переходит в ферромагнитное состояние, с чем, по-видимому, и связана наблюдаемая особенность.

В чистых диэлектриках, где фононный механизм теплопереноса является доминирующим, термодиффузия  $\eta$ , по сути, представляет собой среднюю длину свободного пробега фононов ( $\eta = (1/3)v_S l_{ph}$ ). В данном случае в теплопередаче участвуют и фононы и электроны, а наблюдаемый ход  $\eta(T)$  является суммарным эффектом. Тем не менее примечательно, что суммарная длина свободного пробега носителей тепла в широкой области температур остается постоянной величиной

(рис. 4, справа), что согласуется с нашими предыдущими рассуждениями.

Таким образом, измерены  $\kappa$ ,  $\rho$ ,  $C_p$ ,  $\eta$  ленточных образцов сплава на основе никеля в холоднокатанном и текстурированном виде. Обнаружены различия в поведении  $\kappa(T)$  и  $\rho(T)$ , связанные с образованием кубической текстуры в исследованных образцах при отжиге. Выделены электронная и фононная составляющие теплопроводности, обнаружены особенности, связанные с переходом образцов в ферромагнитное состояние.

Показано, что формирование кубической текстуры сопровождается увеличением фононной составляющей теплопроводности.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-08-96533) и в рамках программы ОФН РАН "Сильнокоррелированные электроны в твердых телах и структурах".

## Список литературы

- [1] Гоял А. Токонесущие ленты второго поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников / Пер. с англ. М.: Изд-во ЛКИ, 2009. 432 с.
- [2] Eickemeyer J., Huhne R., Rodig C. et al. // Supercond. Sci. Technol. 2008. V. 21. P. 1–7.
- [3] Tomov R.I., Kursumovic A., Majoros M. et al. // Physica C. 2003. V. 383. P. 323– 336.
- [4] Huhne R., Subramanya Sarma V., Okai D. et al. // Supercond. Sci. Technol. 2007. V. 20. P. 709–714.
- [5] Родионов Д.П., Гервасьева И.В., Хлебникова Ю.В. и др. // Физика металлов и металловедения. 2009. Т. 107. № 2. С. 198–206.
- [6] Родионов Д.П., Гервасьева И.В., Хлебникова Ю.В. и др. // Письма в ЖТФ. 2010. Т. 36. В. 9. С. 1–10.
- [7] Досовицкий Г.А. / Дис... канд. хим. наук. М.: МГУ, 2009.
- [8] Абдулвагидов Ш.Б., Шахшаев Г.М., Камилов И.К. // ПТЭ. 1996. № 5. С. 134.
- [9] Берман Р. Теплопроводность твердых тел. М.: Мир, 1979. 286 с.